

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-060

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押并购标的全资子公司 股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押并购标的全资子公司股权的议案》。具体情况如下：

一、基本情况

公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“并购标的”）的股权及其控制权，置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为顺利推进本次交易，公司董事会于2025年5月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意向金融机构申请不超过人民币79,079.37万元的并购贷款授信额度，用于支付收购并购标的股权的交易价款及相关事项，并授权公司经营管理层办理上述事项及签署相关的法律合同及文件。

为确保并购贷款的资金安全与风险可控，同时保障整个并购贷款流程的顺利推进与完成，公司董事会于2025年10月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押并购标的全资子公司股权的议案》，拟在本次股权变更完成后，以并购标的持有的全资子公司先进半导体材料（安徽）有限公司及先进半导体材料（深圳）有限公司全部股权为本次并购贷款提供质押担保。

二、拟质押标的公司基本情况

（一）公司名称：先进半导体材料（安徽）有限公司

统一社会信用代码：91341100MA2WP6YL0X

注册资本：16,000 万美元

成立日期：2021 年 2 月 9 日

法定代表人：雷国辉

注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区文忠路 288 号

经营范围：设计、开发、生产、销售半导体专用材料、电子专用设备及零部件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施（负面清单））。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司名称：先进半导体材料（深圳）有限公司

统一社会信用代码：914403007362812201

注册资本：4,783.5 万美元

成立日期：2002 年 6 月 5 日

法定代表人：雷国辉

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 6101-6301、10 栋 1 楼、12-14 栋、15 栋 2-3 楼

经营范围：从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁；企业管理服务。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营） 设计、开发、生产经营半导体专用材料、电子专用工模具；电子专用设备及零部件生产。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请并购贷款并质押并购标的全资子公司股权，充分考虑了公司目前的资金状况以及支付收购并购标的股权交易价款的实际进展情况，有利于本次交易的实施。并购贷款的风险可控，符合公司发展战略，不会对公司及并购标的的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日